



WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA & BE THE GLOBAL NO.1

TAESUNG

Investor Relations 2023



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 Presentation에 정보제공을 목적으로 (주)태성(이하 “회사”)에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 별도 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며,본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다 (과실 및 기타의 경우 포함). 또한 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다.

**WORLD BEST PRODUCTS
BEYOND KOREA
& BE THE GLOBAL NO.1**



Contents

Prologue

01. Company Overview

02. Market Sketch

03. Investment Highlights

04. Growth Strategy

Appendix



Prologue

- 01. 高사양 / 高부가 / 초정밀 PCB 수요의 폭발적 증가
- 02. PCB 종류
- 03. Corporate Identity



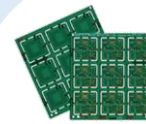
01 高사양 / 高부가 / 초정밀 PCB 수요의 폭발적 증가

PCB 수요 증가는 단기적인 현상이 아닌 3차 산업의 구조적 진화에 기인

온디바이스 AI
(온디바이스 AI
적용 제품 확대)



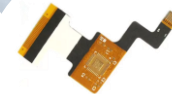
최첨단 PCB 수요 폭증



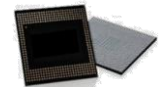
MLB



SLP

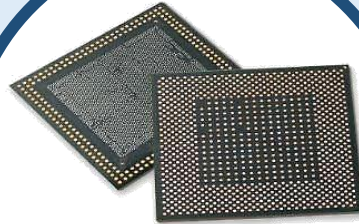


FPCB



CSP

EV 및
전장부품
(자율주행 차량용)



FC-BGA

반도체 Big-Cycle 도래

통신용(5G), 전기차(EV) 및 전장부품, 대용량 데이터센터, 온디바이스 AI기기
수요 급증으로 고집적 고사양의 반도체 수요 급증

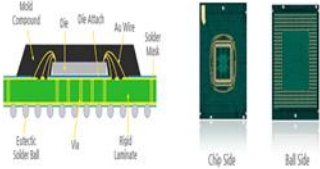
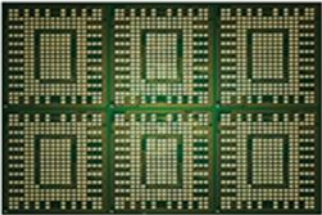
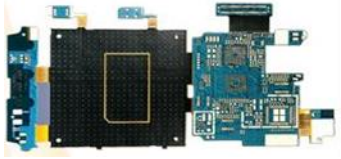
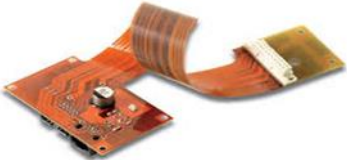
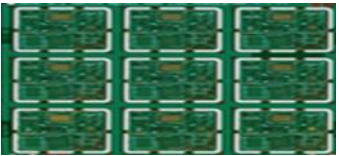
→ 반도체 고집적 등의 성능 향상에 맞춰 차세대 PCB 수요 역시 급증

대용량
데이터센터 등
(메타버스, GPU, 초고속 통신 등)



02 PCB 종류

당사 설비로 생산되는 PCB 종류

PKG (FC-BGA)	PKG (FC-CSP)	RF-PCB
		
온디바이스 AI, 챗GPT, 자율주행車, 데이터 서버 등 CPU, GPU	모바일기기 (AP)	전자부품 산업에 광범위
삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 코리아씨키트	삼성전기, LG이노텍, 대덕전자, 심텍	비에이치, 영풍전자
FPCB	HDI	MLB
		
디스플레이, 모바일 카메라 모듈	5G/6G, 클라우드 컴퓨팅 등	5G/6G, 메모리모듈
비에이치, 영풍전자, 인터플렉스	코리아씨키트, 심텍, 이수페타시스, 비에이치	대덕전자, 이수페타시스

03 Corporate Identity



국내 PCB 공정 자동화설비 No.1 ⇒ PCB 高사양화의 최대 수혜주

T TAESUNG 국내 No.1 PCB 공정 자동화설비 MAKER

PCB 前처리
자동화설비 M/S 1위



글로벌 Big Maker
설비 공급



국내 최초 정면기 국산화 및
"세계일류상품" 선정



표면처리설비 및 식각설비
고도화 기술력 보유

최고의 제품 라인업

주력상품 정면기,
"세계일류상품" 선정

FPCB 핵심공정 설비 등
(D.E.S Line)
프리미엄 PCB 설비 공급

글로벌 Top Tier 고객사 확보

국내외 50여개
PCB Big Maker 고객군 확보

핑딩(폭스콘 자회사),
SCC(선난써키트),
Fast Print(홍삼사),
삼성전기, LG이노텍 등

해외 거점 확보

PCB 최대 생산국인 중국내
생산 및 영업 거점 확보
신흥 동남아지역 확대 대비
베트남내 영업 거점 확보

설비 매출의 수출비중 28%
(2023년 기준)

PCB 高사양화에 따른 역할 확대

다양한 제품군과 검증된
기술력 바탕으로,
FPCB, FC-BGA, CSP 등
차세대 프리미엄 PCB
공정설비 개발 / 납품

1. Company Overview

- 01. 회사 현황
- 02. 성장 연혁
- 03. 사업장 현황
- 04. 사업영역
- 05. 제품소개
- 06. R&D현황
- 07. 재무성과 (1),(2)



01 회사 현황



일반 현황

회사명		주식회사 태성
대표이사		김종학 (金鍾學)
설립일		2006년 6월 법인설립 (2000년 8월 태성엔지니어링 창업)
자산/ 자본		572억원 / 337억원
자본금		25.8억원 (액면가 100원)
주요사업		PCB 자동화 설비 개발/ 제조/ 판매
사업장	한국 본사	경기도 안산시 단원구 해안로 228
		종업원수: 128명
	해외 법인	태성(주해)과기유한공사 (중국 광둥성 주해시)
		태성아시아 (베트남 하노이 빈푹성)
R&D		총 22명: 부설연구소 3명, 설계/시스템개발 19명

※ 2024년 3월 기준 (별도재무제표)

CEO Profile

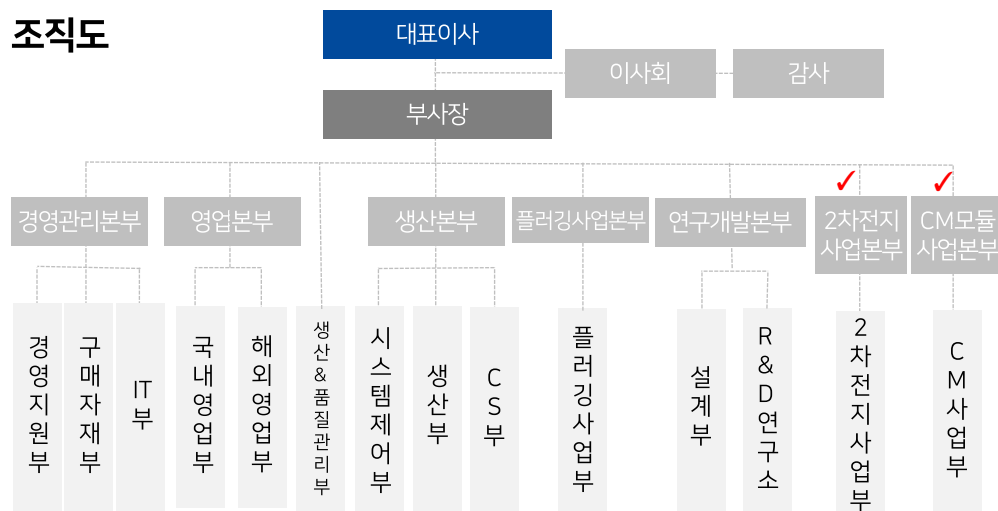


김 종 학

대표이사 사장

- 일진그룹 엔지니어
- 에덴기계 공장장
- 태성엔지니어링 대표
- 現 (주)태성 대표이사

조직도



02 성장 연혁



내수 중심에서 수출 중심 글로벌 기업으로 도약

1. 창립기

2000년~2005년



"PCB설비 국산화 선도"

- (00) 태성엔지니어링 창업
- (01) PCB 정면기, 동분여과기 개발
- (03) 중국 수출 개시/ Foxconn 社
중국 상하이 대리점 설립
- (04) FPCB 정면기 개발 및 상용화
- (05) 전자신문주간 올해의 히트상품
중국 수출 본격화/ZDT 外

2. 기반조성기

2006년~2010년



"제품라인 확대"

- (06) (주)태성 법인설립 (2.5억)
- (08) 박판형 JET SCRUBBER 개발
PCB 습식 설비 생산 출하 개시
- (09) 세라믹브러시 해외수출-중국/대만
일본 수출 개시/메이코 社
일본 수출 본격화/이비덴 社
- (10) 정면기 부문 → 세계일류상품선정
무역수출 100만불탑 수상

01

02

04

03

4. 도약기

2015년~2022년



"해외 거점 확대로 성장 본격화"

- (18) 태성아시아(베트남) 법인 설립
- (20) 소재·부품·설비 전문기업인증
- (22) 코스닥 상장 (SPAC합병)
무역수출 3,000만불탑 수상
- (23) 주해태성(중국) 법인 설립

3. 성장기

2011년~2015년



"수출 확대 및 해외거점 확보"

- (11) 무역수출 300만불탑 수상
- (13) 무역수출 500만불탑 수상
동관태성(중국) 법인 설립
- (14) 진공 이류체 DES 양산
- (15) 무역수출 1,000만불탑 수상
대통령 산업포장 수상

03 사업장 현황



국내사업장



한국 본사	주식회사 태성
소재지	경기도 안산시 단원구 해안로 228
규 모	대지 2,000평 (6,598㎡) 연면적 4,124평 (13,631㎡)
생산품목	PCB 정면기, WET 설비
임직원수	128명
생산전략	고부가가치 제품개발 Premium급 설비 양산
지분사항	*태성(주해)과기유한공사 (지분 100%) *태성아시아 (지분 100%)
기타 사업장	플러깅사업본부 : 안산시 단원구 신원로 305 카메라모듈사업본부 : 안산시 단원구 해안로 85

해외사업장



중국 법인	태성(주해)과기유한공사 (TEASUNG (Zhuhai) Technology Co., Ltd.)
소재지	중국 광둥성 주해시 고신구
사업목적	PCB 자동화설비 제조, 영업, CS 등



베트남 법인	태성아시아 (TAESUNG ASIA Co., Ltd.)
소재지	베트남 빈옌시 빈폭성
사업목적	영업, CS 등

04 사업영역

핵심기술 간 융합으로 다양한 산업에 적용 가능한 PCB 제조 공정 자동화 설비 개발

사업영역



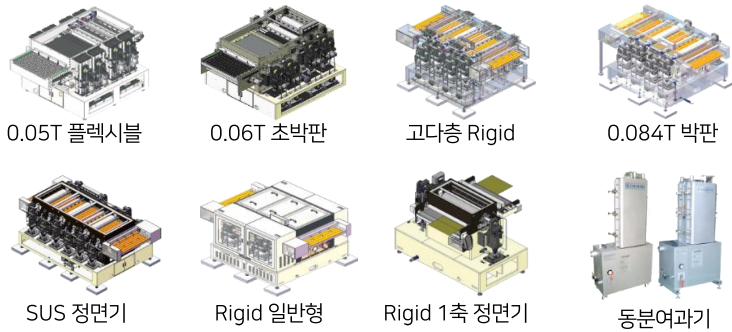
05 제품소개

세계 최고 수준의 품질 및 기술 경쟁력을 갖춘 다양한 제품 LINE UP



주력제품군 : 주력제품군

정면기 주요 경쟁사 대비 박판 대응 능력 우수한 다양한 제품군의 정면기 생산



기타 세라믹 브러시 제조/판매(PKG 기판 전용) 등



국내 유일한
#2,000이상 급
세라믹 브러시 제조

PKG 기판 신규 공법 투자 및 FC-BGA
투자로 인한 HPP 연마기 및 세라믹
브러시 수요 증가

표면처리설비 20여종 이상의 다양한 공정의 표면처리 설비 제작



식각설비



PCB용 식각설비 외
OLED 용 Metal
Mask, Lead Frame
등 제품군 확장

수직비접촉설비 등



수직비접촉설비

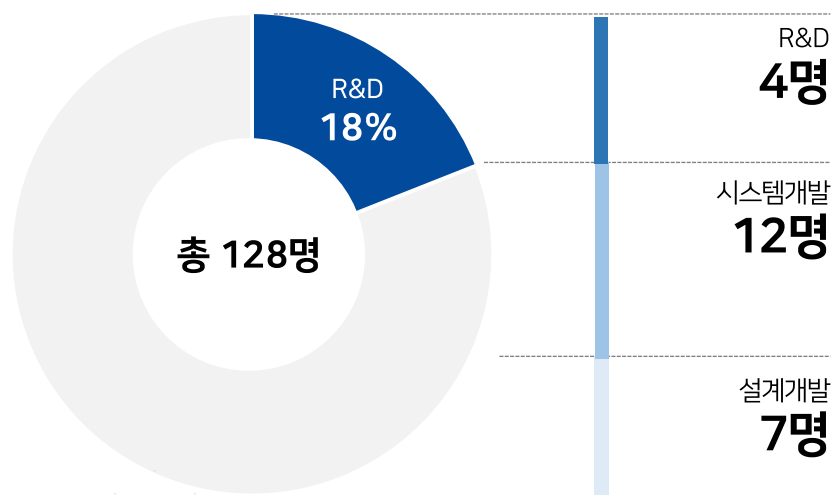
자동화설비

06 R&D현황

연구개발 인프라를 기반으로 지속적인 투자와 신제품 개발 집중



R&D 인력현황



**파트별 총 23명의
연구개발 전문인력 보유**
(R&D연구소 외 시스템개발 인력 포함)

특허 등록 / 출원 현황

특허 등록 현황	
1	기판이송장치
2	매칭액 공급구조체
3	인쇄회로기판의 에칭방법 및 에칭장치
4	인쇄회로기판의 습식 에칭 공정에서 기판 위의 퍼들링 제거를 위한 흡입 롤러 장치
...	
26	카메라 모듈용 조리개 의제조방법
27	인쇄회로기판용 지그장치
28	기판의 산화방지장치

국내외 특허 등록 28건 / 특허 출원 9건

국책과제 수행 현황

연구과제명	
1	PCB 정면 처리용 초박판 정면기 개발 (기술혁신개발사업)
2	진공 및 이류체 적용한 초미세회로 PCB용 Subtractive Wet Etch System 개발 (수출기업개발사업)
3	PCB 0.06t 이하 제품 생산을 위한 Sheet/Roll to Roll 정면 System 개발 (수출기업개발사업)
4	광폭, 박판의 FPCB 롤투롤 수평 전해도 Pattern Plating System 개발 (수출기업개발사업)

국책과제 수행 4건 (24.9억원 지원)

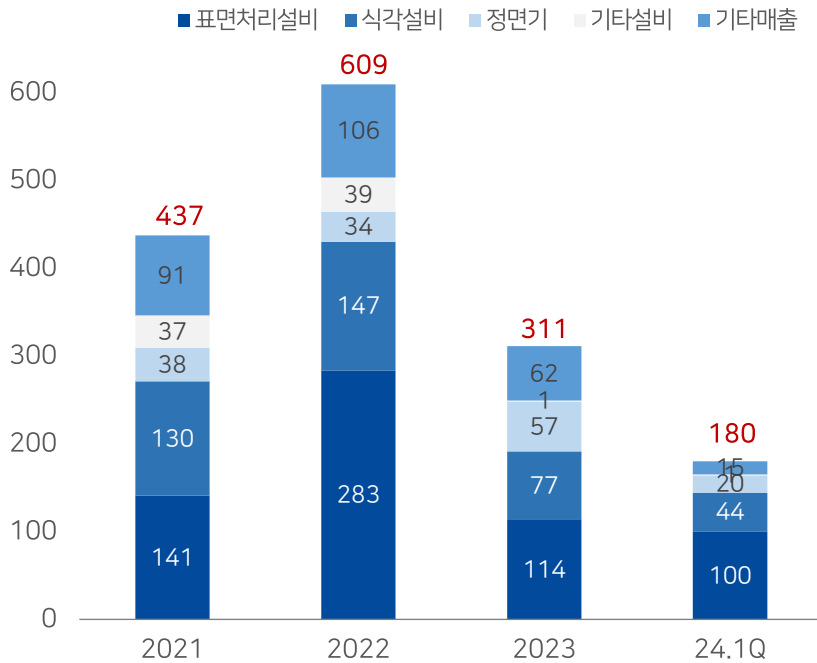
07 재무성과_(1) 경영실적

세계경제 성장둔화로 인한 투자 위축, 24년 회복 예상



제품별 매출

(단위: 억원)

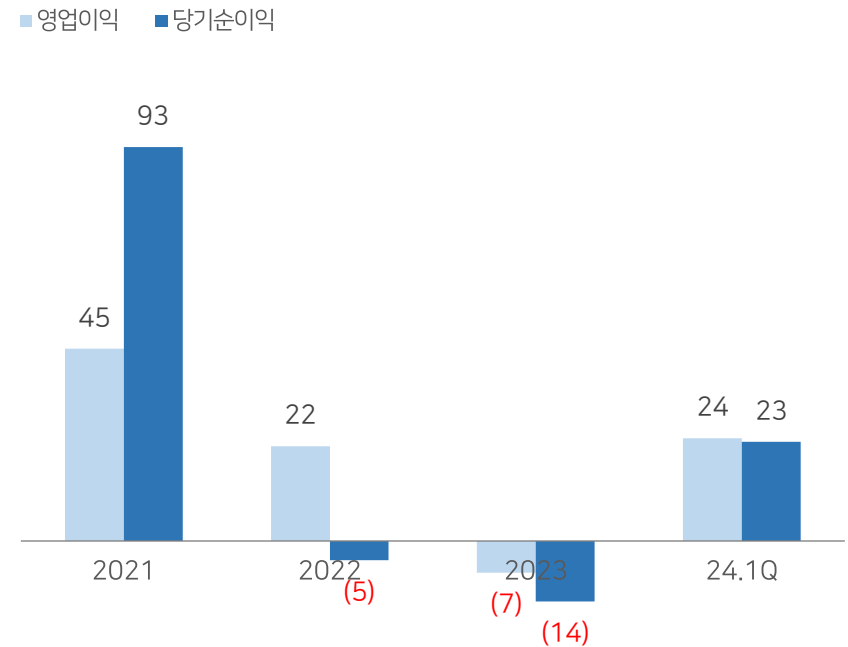


※ 별도재무제표 기준

- PKG기판신규 공법 & FC-BGA 및 FC-CSP 투자 지속
- 다축 정면기(8축, 12축, 16축 등) 수요 증가 및 세라믹 브러시 사용량 증가 예상
- 온디바이스 AI 적용 확대에 따른 PCB 생산량 증가로 인한 투자 확대

영업이익 및 당기순이익

(단위: 억원)



※ 별도재무제표 기준

- 2021년 RCPS 평가손익 반영에 의한 당기순이익 변동성 발생
- 2022년 1회성 등 비용 60억 (합병비용 28억, 주식보상비용 13억, 대손 13억 등)
- 2023년 매출감소에 따른 수익 감소

07 재무성과_(2) 안정적인 매출 구조

매출처 확대를 통해 수주기반 안정적 매출 확보

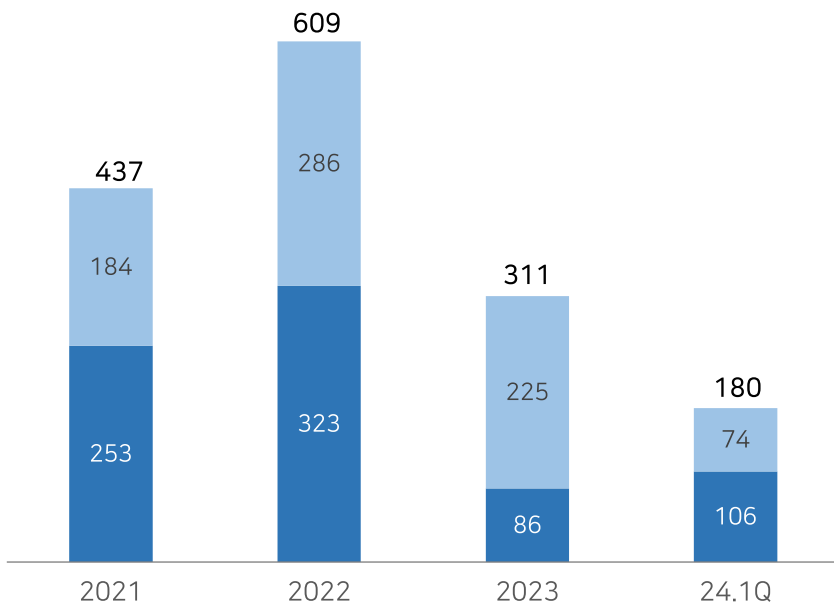


국내 / 해외매출

(단위: 억원, %)

■ 해외매출 ■ 국내매출

“국매 및 해외 구매선 확대로
Turn-around 기반 마련”



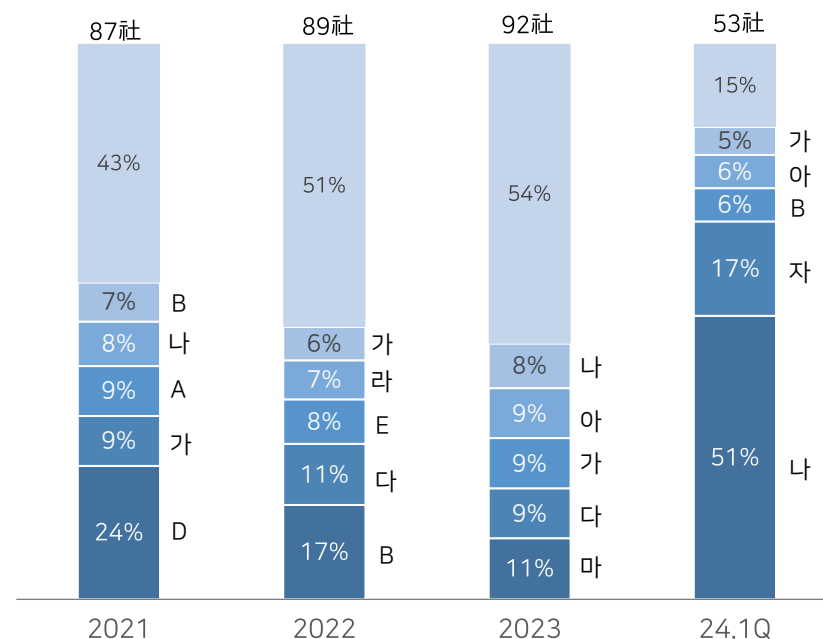
※ 별도재무제표 기준, (%)는 제품매출 기준

고객사별 매출 비중

(단위: %)

■ 1위 ■ 2위 ■ 3위 ■ 4위 ■ 5위 ■ 기타

“다양한 매출처 확보를 통해
매출 안정성 강화”

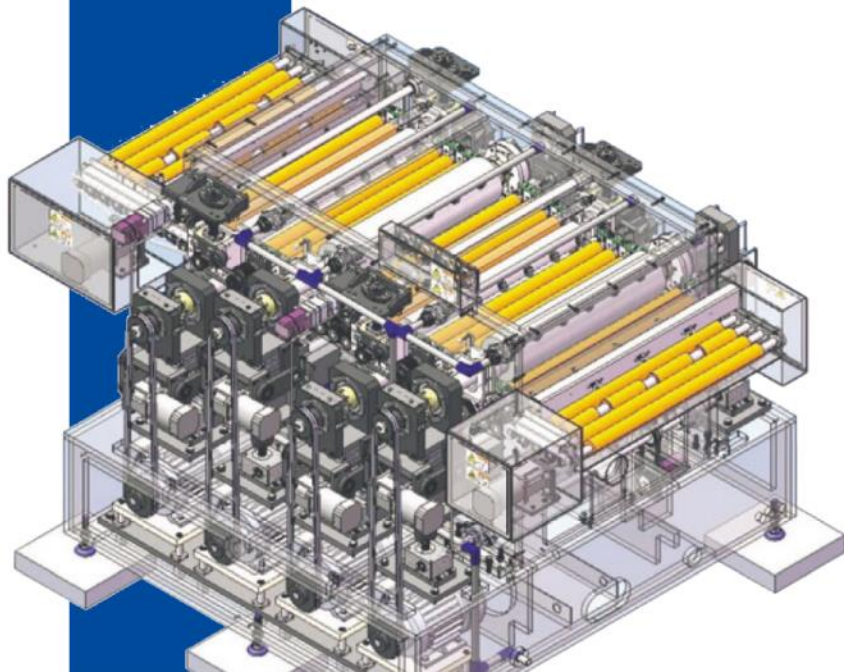


※ 별도재무제표 기준, 가나다 : 국내기업 / ABC 해외기업

2. Market Sketch

01. 전방산업 동향 (1)

02. 전방산업 동향 (2)



01 전방산업 동향 (1)

반도체, 전자부품, 통신(5G) 등 4차산업을 필두로 아시아지역이 PCB 생산의 메카

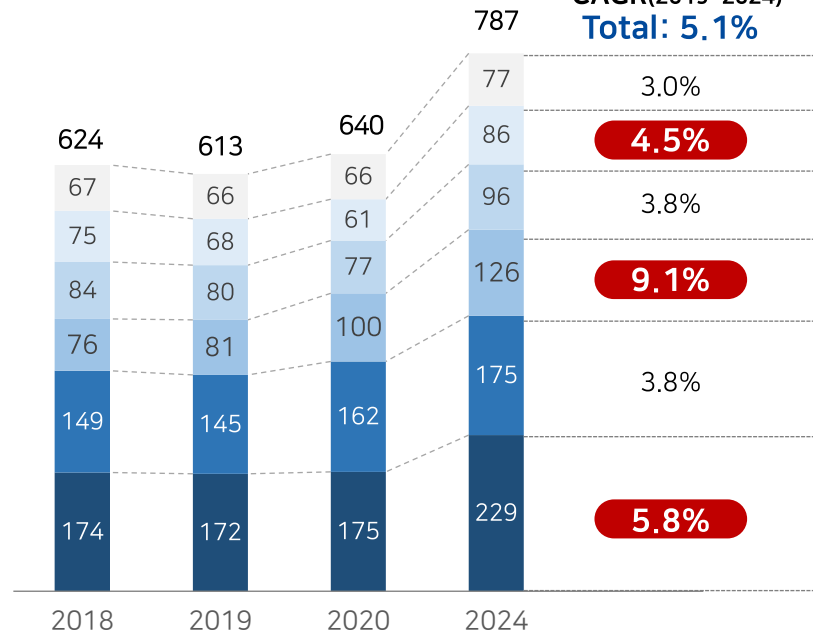
PCB 분야별 시장전망

(단위: 억\$)

PCB 산업은 통신, 전자, 반도체 패키지 분야를 중심으로 고성장세 시현

■ 통신 ■ 컴퓨팅 ■ 반도체패키지 ■ 가전 ■ 전자 ■ 기타

CAGR(2019~2024)
Total: 5.1%

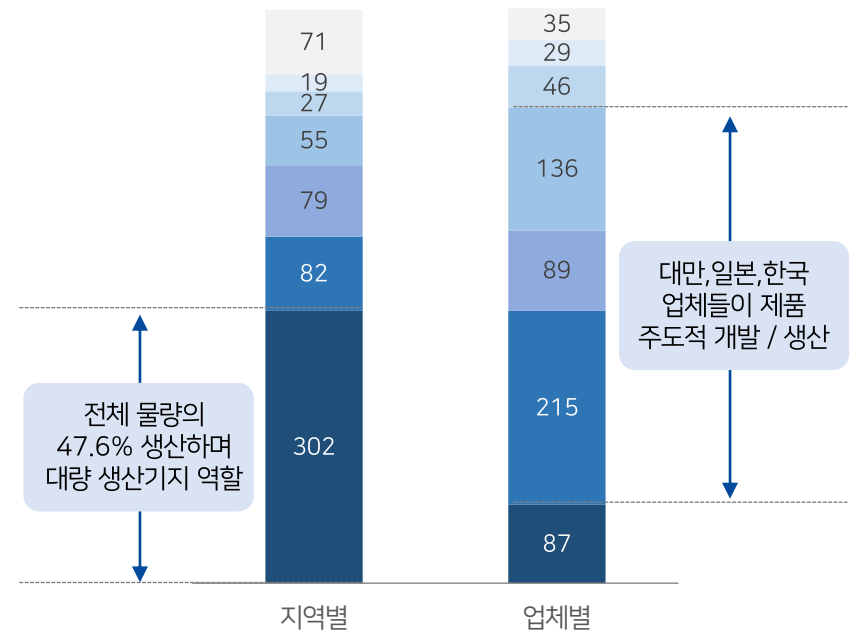


※ 출처: Primark

PCB 생산 현황 (지역별 / 업체별)

(단위: 억\$)

■ 중국 ■ 대만 ■ 한국 ■ 일본 ■ 미국 ■ 유럽 ■ 기타



※ 출처: WECC, CPCA, IPC, JPCA, TPCA, HKPCA

02 전방산업 동향 (2)

국내 / 중국 PCB 산업 현황

국내 주요 PCB 업체 투자 현황



SAMSUNG 삼성전기

FC-BGA 보완 투자

LG LG이노텍

FC-BGA 2차 투자

DAEDUCK

MLB 보완 투자

SIMMTECH

FC-CSP 보완 투자

ISU 이수페타시스

MLB/HDI 신규/보완 투자

SEOJIN SYSTEM

MLB 투자

EV첨단소재
Electric Vehicle Advanced Materials

R/F 투자

TLB
Thin Lamination Board

MLB 투자

비에이치

HDI 투자

LX Semicon

세라믹 투자

※ 위 내용은 당사의 영업상황을 판단으로 작성된 내용입니다.

중국 PCB 산업 현황



PCB제조업체 매출
상위 50개 중 중국업체 27개



50% 육박하는
세계시장 점유율



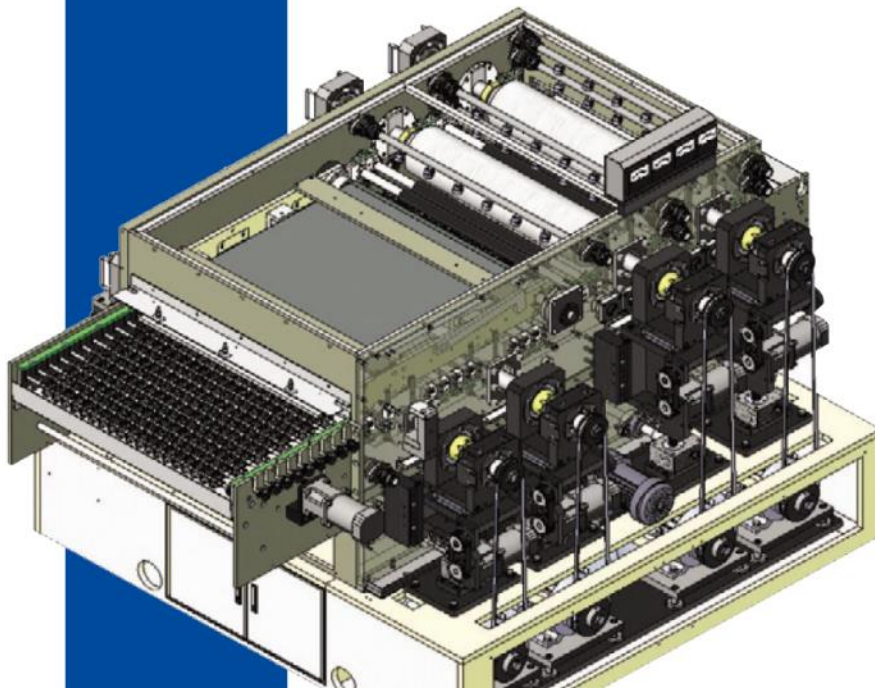
막강한 내수시장

**BGA, CSP에 대한 수요 증가로
생산 공정 고도화 니즈 증대**

※ 출처: Dr. Hayao Nakahara of NITI at the end of July 2021

3. Investment Highlights

- 01. PCB 공정 자동화 부문 Unique Total Provider
- 02. PCB 공정 자동화 설비 매출 1위
- 03. 국내외 Top tier 공급 레퍼런스 확보
- 04. 수주증대로 성장기조 유효



01 PCB 공정 자동화 부문 Unique Total Provider



PCB 제조 장치 산업내 필수설비 제조

PCB 생산 공정내 역할

● : 당사 공급 ● : 미공급

“ PCB 생산 공정 전반에 걸친 제조 자동화설비 개발/공급 ”



국내 최초 정면기 개발로
생산 수율 개선 및 초정밀도 향상
→ 세계일류상품 선정



IMAGE 핵심공정인
D.E.S Line
세계 최고 기술력 보유



전, 후공정 완전 자동화 선도
수동·반자동화
→ 완전 자동화 공정설비로 대체

02 PCB 공정 자동화 설비 매출 1위



기술 경쟁력 기반 공정 자동화 설비 시장 점유율 확대 지속

공정 자동화 설비 개발 스토리



세계 초일류 상품으로 PCB 공정 자동화 설비 국산화 선도

- PCB 前처리 공정 부문 선도
→ 공정 자동화 설비 국내시장점유율 1위
- 다양한 PCB 핵심자동화 설비 Line Up 확보

세계 최고품질의 D.E.S Line 설비

- PCB공정자동화설비부문 확고한시장 지배력보유
→ Lock in 효과를 통한 시장 점유 확대
- 세계 1위의 기술경쟁력 보유

Turn-key Solution 구축

- 고객수요에 맞춘 Turn-Key Solution 구축
- 축적된 핵심기술 Know-how 기술경쟁력 기반 차세대 융복합 설비 개발 지속

VS

후공정 검사설비 등에 주로 적용

상대적으로 低난이도
PCB 후공정 설비에 주로 납품

경쟁사 현황

특정 라인의 단품 설비 위주 공급

기술력 격차로 인한
프리미엄 설비 시장 진입 난항

03 국내외 Top tier 공급 레퍼런스 확보



우수한 제품 바탕의 국내외 50여개 고객사 포트폴리오 확보



Lenovo **Apple** **MI**

SAMSUNG 삼성전기 **LG** LG이노텍 **DAEDUCK** **Korea Circuit**

글로벌 Big Maker에 PCB 생산 설비 공급
글로벌 PCB시장 30위권 업체 매출 비중 70~80% 유지

중국10대기업 공급



국내 고객사



해외 고객사

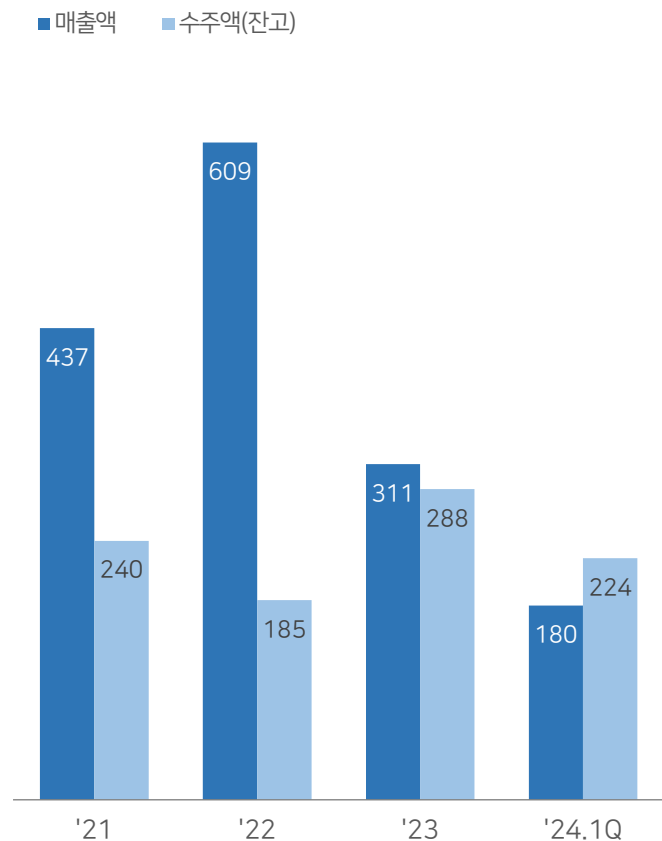


04 수주증대로 성장기조 유효

미·중 반도체 패권경쟁에 따른 중국내 투자 위축 → 2024년 국내외 설비 투자 확대

매출액 / 수주잔고 추이

(단위: 억원)



※ 출처: 별도재무제표 기준

수주잔고 증감 요인

01 고객사 설비 투자 증가

- 중국 및 국내 대규모 공장증설에 따른 투자 증가, 반도체 패키징 투자 2~3년간 지속 전망
- AI 온디바이스 등 투자 확대에 수주 증가

02 프리미엄급 설비 수주 확대

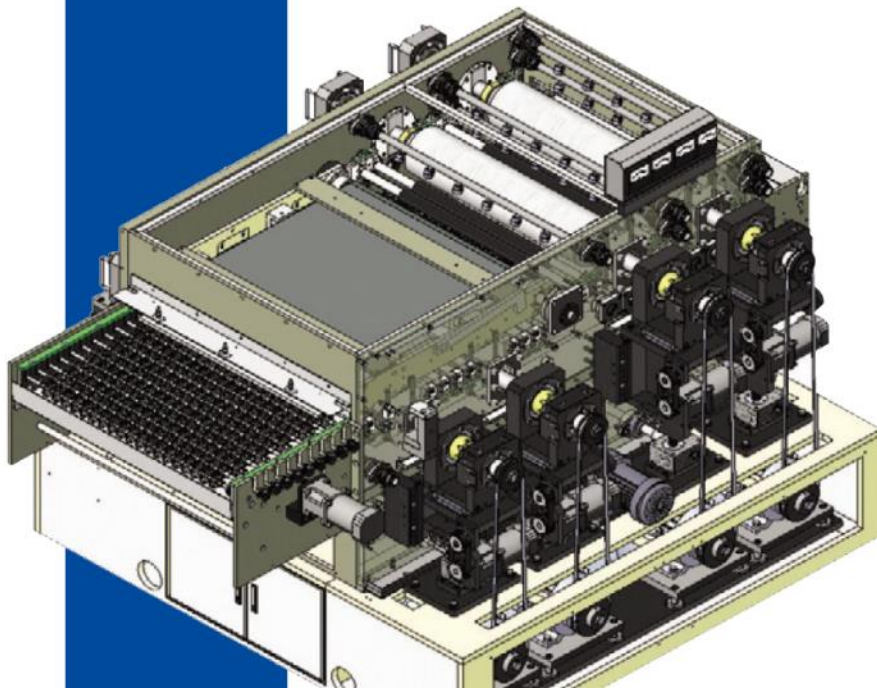
- FC-BGA, FC-CSP 투자 증가하며 프리미엄 설비 공급 확대에 따른 제품 평균단가 증가

03 고객사별 수주규모 확대

- 프리미엄급 설비의 경우 안정성 담보를 위해 단품보다 Turn-key 공급 비중 확대
- 국내외 신규 고객사 발굴을 통한 수주 확대
- 투자사 생산품목 확대에 의한 수주 확대

4. Growth Strategy

- 01. 글로벌 Player 위상 강화
- 02. 고부가가치 설비 확대
- 03. 신규 설비 개발 확대
- 04. 명실상부한 종합 PCB 제조설비 Maker로 자리매김
- 05. 신규 사업 확대
- 06. Vision



01 글로벌 Player 위상 강화

중국 및 베트남 법인 구축으로 글로벌 시장 공략 가속화

"PCB 생산량의 80%가 중국과 동남아시아에 집중"



아시아지역 비중 확대



해외 수출 확대 및
전략적 마케팅

대만 시장 확대

- FPCB 설비 신규 진입 및 생산량 증가
- 세계 PCB 상위 기업 포진에 따른 공략

→ 팅딩(Foxconn 자회사) 진입 및 공급 확대

중국 시장 확대

- 중국 내 다국적 PCB 생산기지 확대
- 반도체용 PKG 설비 신규 진입 확대

→ 동관태성기계 유한공사(중국)의 영업 및
제조인력의 충원을 통한 설비제작 가동률 제고

동남아시아 시장 확대

- 베트남, 동남아 제1의 PCB 생산국 안착
 - 태국, 말레이시아 동남아 제2의 PCB 생산국 급부상
- 태성아시아(베트남)를 통해 동남아시아 시장
공략 및 향후 수요발생시 제조공장 운영계획

02 고부가가치 설비 확대

응용제품 및 융복합설비 개발을 통한 시장 확대 및 매출 성장 달성

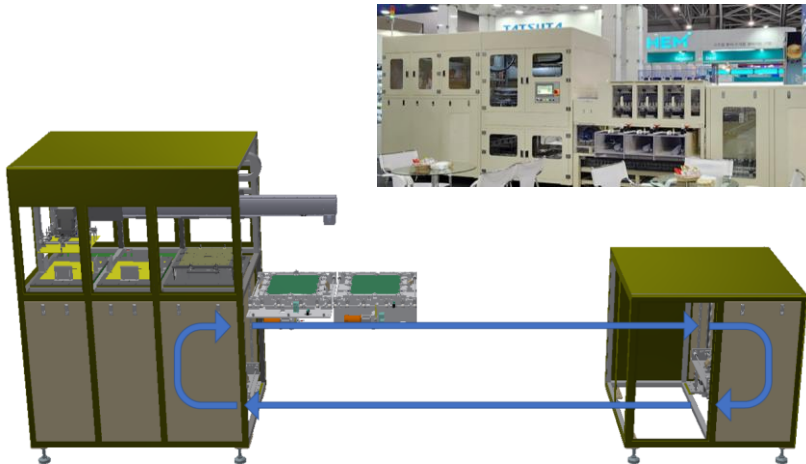


03 신규 설비 개발 확대

신규 설비 개발을 통한 시장 대체 및 매출 성장 달성



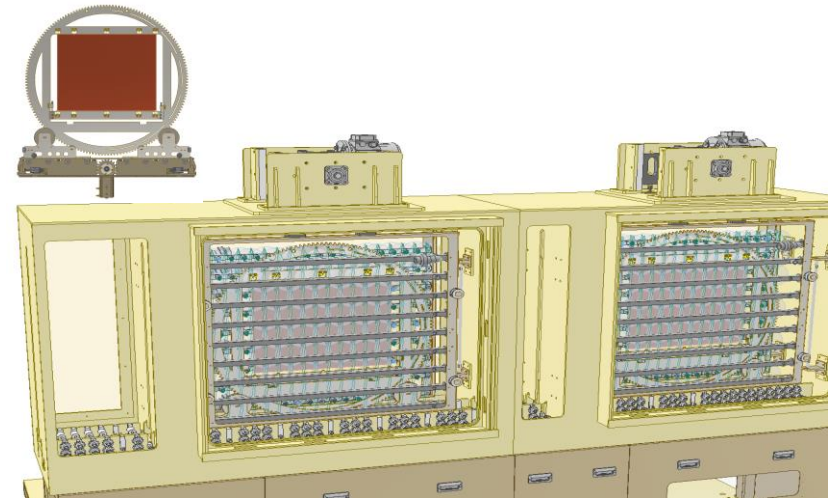
Tilt 구동방식 Wet 설비



- 비접촉 Jig + 5° Tilt
- Jig반송이 장비 하부로 이송
(maintenance & Safety ↑)
- 제품 상부 액 pudding효과를 개선하기 위한 Tilt 적용

※ 특허 등록번호: 10-2538707

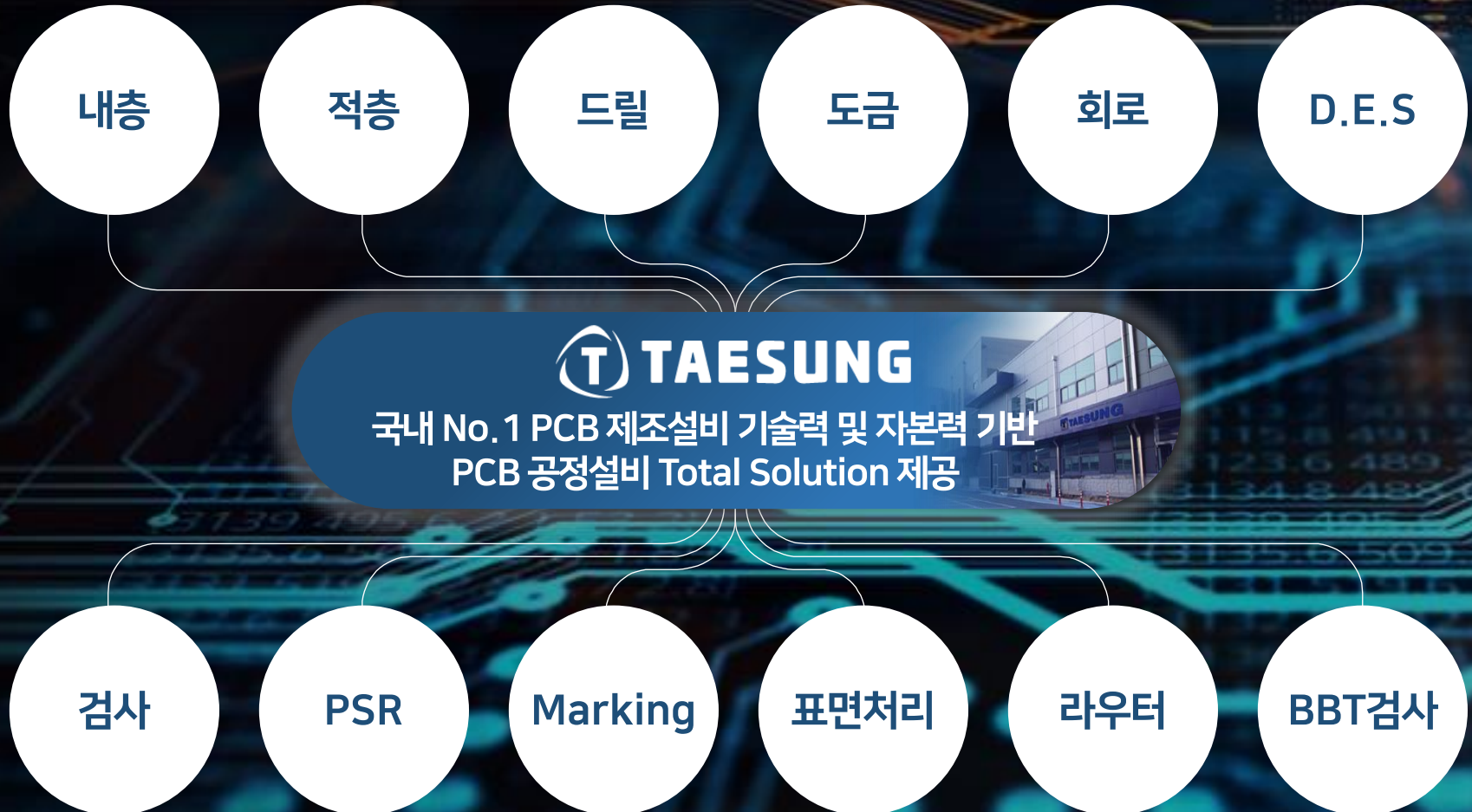
수직 Turn 에칭(식각) 설비



- 비접촉 + Oscillation + 회전 Etching
- 수직 회전방식을 적용한 Etching 장비
에칭 Uniformity ↑ (제품 처짐 ↓)
- 약품에 대한 제품 양면의 대칭성

※ 특허 등록번호: 10-2296192

04 명실상부한 종합 PCB 제조설비 Maker로 자리매김



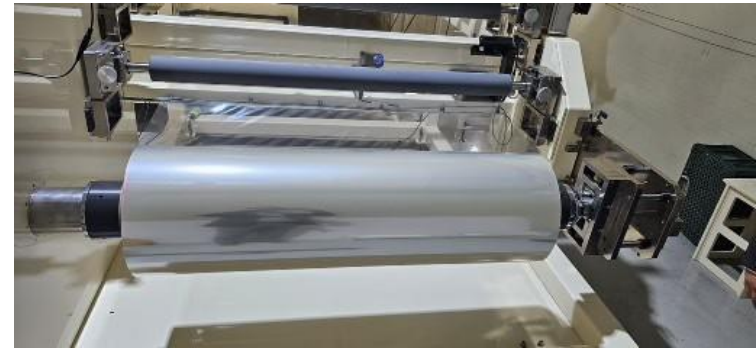
05-1 신규 사업 확대 2차전지 복합 동도금설비 (음극재)

RtR 동도금 설비 개발

배터리 최근 동박의 무게와 두께를 줄일 수 있는 방안에 대해 Global적으로 개발 진행 중



- 수평이송 방식 및 신 도금방식 적용한 복합 동박 설비 제작 (특허출원번호 10-2023-0147928)
- 데모장비 제작완료
- 5월중 동도금 제품평가 완료 목표
- 품질 만족 시 즉시 양산설비 납품 계약 진행

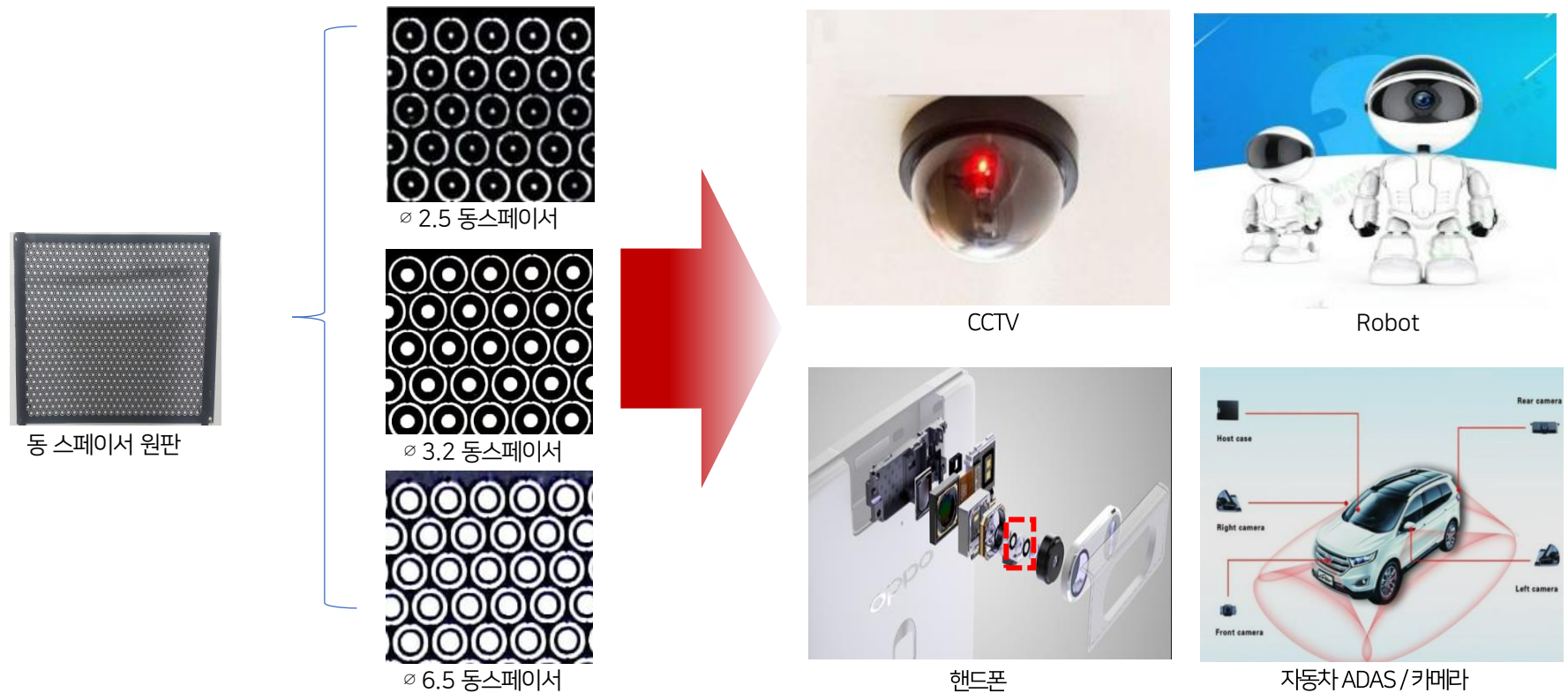


05-2 신규 사업 확대 카메라모듈 사업 (M.Spacer / 실드캔)

05-2.1 제품소개 (카메라 모듈)

고성능 품질의 조리개 부품 생산 LINE UP

카메라 핸드폰/자동차 ADAS/CCTV등 카메라 렌즈의 조리개 역할로 현재의 필름 Type보다는 빛 흡수율이 뛰어나 플레어 (Flare) 현상을 방지



05-2.2 조리개_Metal Spacer 란



[기존 smart phone 카메라 구조]
F2.4 조리개 + 렌즈 5매

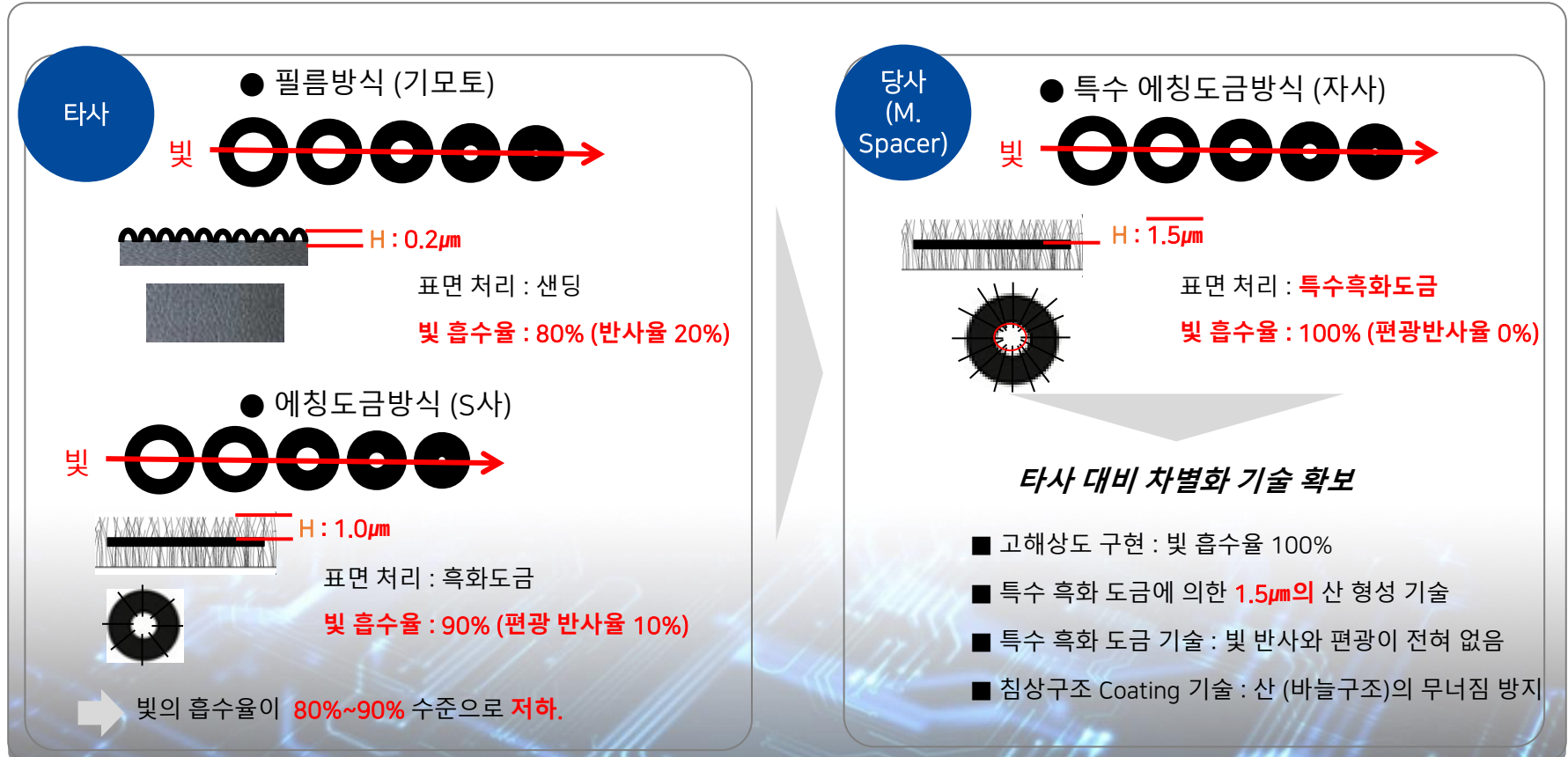


[G4 카메라 구조]
F1.8 조리개 + 렌즈 6매



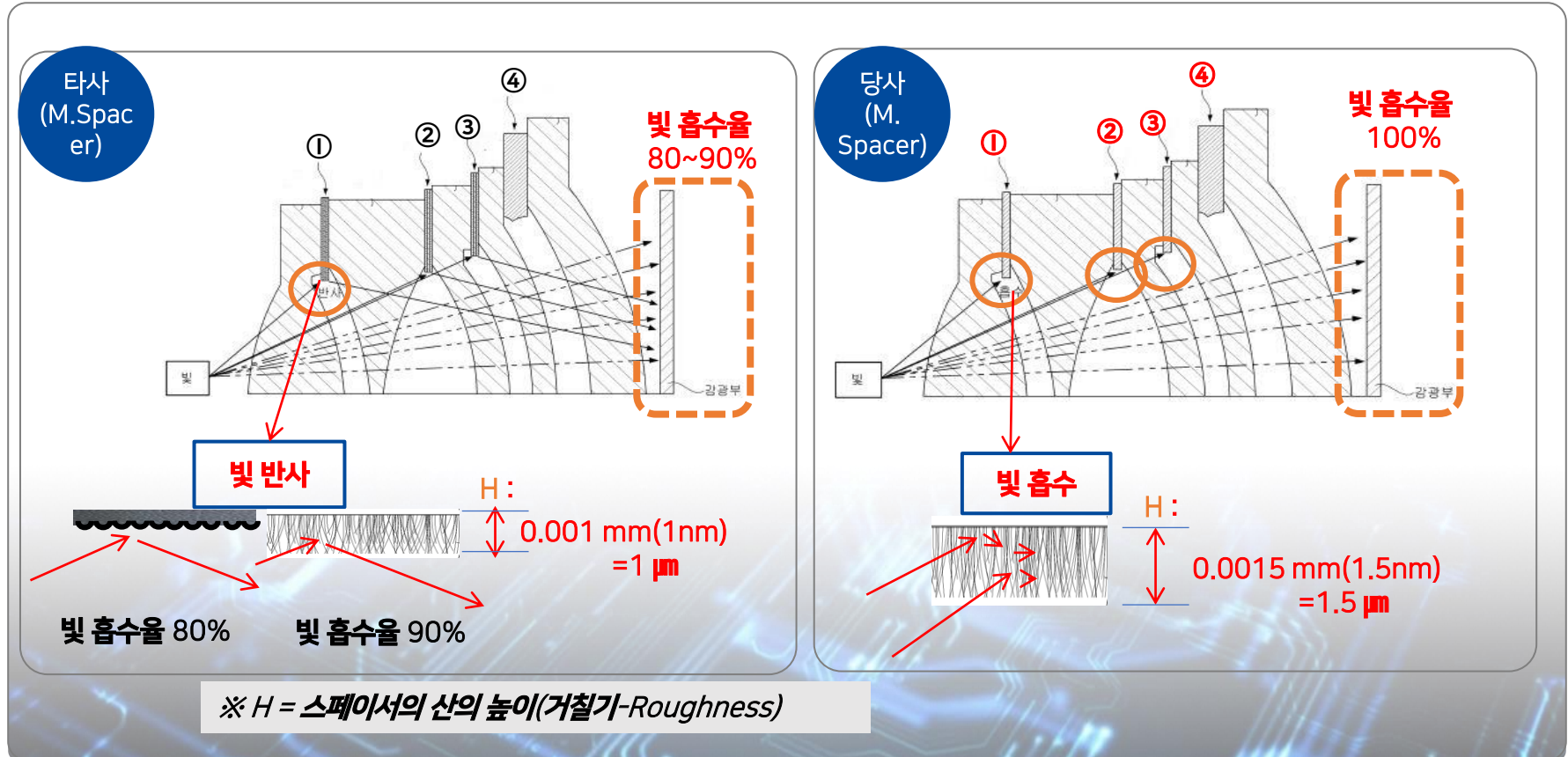
카메라모듈 즉, 이미지센서를 활용, 렌즈를 통해 들어오는 광신호를 RGB (Red,Green,Blue) 전기신호로 변환해 휴대폰, 블랙박스 등 디지털영상기기의 화면에 디스플레이 해주는 부품의 렌즈들 사이에서 빛의 양을 조절하고, 렌즈의 간격유지 역할을 수행하는 와셔 형태의 M.Spacer (조리개)

05-2.3 조리개_Metal Spacer 타사 기술 비교



빛 흡수율이 80~90%인 수준을 특허 기술인 특수 흑화 도금 방식을 적용함으로써
빛 흡수율이 100%인 고해상도용 카메라 모듈을 구현할 수 있음.

05-2.4 조리개_Metal Spacer Flare 개선 Mechanism



당사의 Roughness가 1.5배 수준으로 빛 흡수율이 높아 Flare 현상 개선이 됨.

※ Flare(플레어) 현상 : 광학기계의 내부에서 빛의 일부가 반사, 산란되어 본래 관측하고자 하는 대상물의 상에 포개져 확산되는 빛 산란현상,

06 Vision

“PCB자동화 설비 국내 1위를 넘어, **세계 일류로 도약하는 기업**”



한국 본사와 중국, 베트남 법인과의 Collaboration을 통한 글로벌 매출 확대로
2025년 매출 1,500억 원 목표

응용제품
확대

글로벌 매출
확대

신사업 동력
확보

핵심 역량

01

차별화된
제품 경쟁력

02

축적된 설비개발
Know-How
핵심 원천기술 보유

03

수익성 증대 및
건실한 재무구조

04

안정적인 매출구조
우량고객 저변확대